第五届全国高分子科技与产业创新峰会

第一轮通知

2025年8月21-24日 山西.太原

高分子材料持续深刻地影响着人们的生产和生活，它的使用对全球经济产生了巨大的影响，已成为当今社会产业发展最快和需求增长最快的材料。随着高分子材料在工业、农业、交通、建筑、汽车、电子电器、航天航空、国防工业以及人们衣食住行中越来越多的应用，许多科学问题与技术瓶颈不断涌现。为了在高校、科研院所与产业企业之间架起沟通交流的桥梁，更好地实现高分子材料的产、学、研、用，特别是高分子材料的高性能化、功能化的研发及产业化应用，进一步提高高校的科技成果转化，2016年高分子科研与产业界几位志同道合的青年学者联合发起“高分子材料产学研论坛”，自第四届更名为“高分子科技与产业创新峰会”，现已成功举办四届，反响热烈。本届峰会热忱欢迎全国与海外的高分子专家学者踊跃参加，依据峰会（论坛）的传统，大会组委会将竭诚为与会代表提供口头报告自己成果的机会。

本届峰会将集中邀请国内外高分子相关领域（包括材料、化学、电气、自动化等）专家学者和企业代表参加，拟邀请院士1-2名，杰青/长江学者4-6名，国外著名学者3-4名，国内知名学者25-30人，相关企业代表30-40人参加。会议已取得相关重量级行业协会、学会以及中国聚合物网、核心期刊等媒体单位部门的支持，届时将邀请相关领导出席会议。

现诚邀您参会、投稿交流，期待着与您相聚龙城太原！

一、会议时间与地点

时间：2025年8月21-24日

地点：山西·太原

二、会议组织机构

主办单位：长安大学

太原工业学院

承办单位：长安大学材料科学与工程学院

太原工业学院材料工程系

期刊支持：《高分子学报》；《高分子通报》；《中国塑料》；《塑料助剂》

平台支持：中国聚合物网(www.polymer.cn)；高分子科技(公众号)

组织委员会：

名誉主席（按姓氏汉语拼音汉语为序，下同）

陈忠仁 徐志康 王旭 杨卫民 朱锦

共同主席：

程建军 黄俊 李书润 颜录科 张兴宏

执行主席：

李振中 翟燕

学术委员会（顾问）：

包永忠、蔡智奇、曹堃、陈红征、陈立新、陈义旺、陈涛、丁书江、董淑祥、杜建忠、方征平、封伟、冯嘉春、冯传良、冯杰、付绍云、付强、高长有、顾军渭、郭宝华、郭宝春、韩小瑜、洪向明、黄进、黄瑞杰、焦斌、蒋璠晖、孔杰、李勇进、李忠明、李鹏、李娟、李熹平、李化毅、李磊、李志杰、李云全、刘春太、刘民英、刘平伟、刘正平、刘天西、刘学、刘军磊、刘凯强、卢灿辉、吕挺、门永锋、戚栋明、钱志勇、任英杰、宋义虎、孙文华、汤龙程、武培怡、谢毅、许忠斌、徐立新、严锋、杨鹏、杨晋涛、杨建海、杨利平、杨涛、姚水良、叶南飏、殷鹏刚、由吉春、王玉忠、王震、王金立、王仕峰、王玮、章明秋、张立群、张诚、张广成、张水洞、张才亮、张先明、张军、张超、张拥军、赵朋、周光大、朱峰

秘书长：郝明正 刘冰肖

会务组：边祥成、贺茂勇、张涛、王玉龙、张伟、王林艳、侯敏杰、王剑、刘文影、贺雅悦

三、会议主题

主题 A 高分子材料合成、结构与性能

主题 B 高分子材料成型与加工

主题 C 通用高分子高性能化与功能化

主题 D 聚合物基合金材料

主题 E 功能材料与复合材料

主题 F 生物医用高分子材料

主题 G 废旧高分子材料绿色再生与高值化利用

主题 H 高分子材料产业化与工程装备技术

主题 I 高分子教学/工程认证专场

四、论文摘要提交

论文摘要将汇编成论文摘要集，供论坛交流。论文摘要（word格式）请于2025年7月25日前发至联系人信箱（bxliutg@163.com）或在线提交。会议现场将评审优秀论文与优秀报告，并将优秀论文推荐到核心期刊审核录用。有关会议信息请查阅中国聚合物网上的本次大会主页（延后公布）。

五、会议相关费用

会议注册费：1,800元/人（学生1,200元/人），含论文摘要集、会议费和会议期间餐费；企业发布技术需求的5,000元/项，含技术需求册整理发布与现场对接会。住宿统一安排，费用自理。

展示推广：会场展台10,000元/个。参会代表可在网上注册，也可填写本次大会第一轮通知中的回执，并将回执传给会议联系人邮箱。

热忱欢迎相关企业赞助本次会议，具体赞助方案请与会务组联系。

六、会议联系人

颜录科：15909291979，lkyan@chd.edu.cn

李书润：13466719937，shurun.li@foxmail.com

刘冰肖：18135376002，bxliutg@163.com

附件 2：摘要模版

标题（黑体，三号）

第一作者等¹，通讯作者^{1,*}（仿宋，四号，作报告者请加下划线）

¹作者单位（宋体，五号）

*通讯作者邮箱地址（Times New Roman，五号）

摘要：宋体，五号，1.5倍行距

关键词：宋体，五号

参考文献

[1] 请参考ACS期刊格式.